

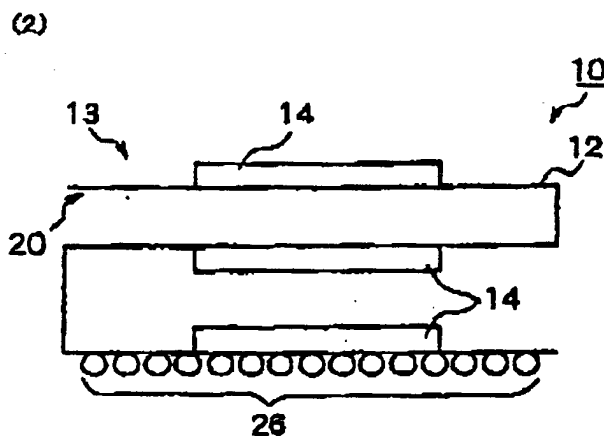
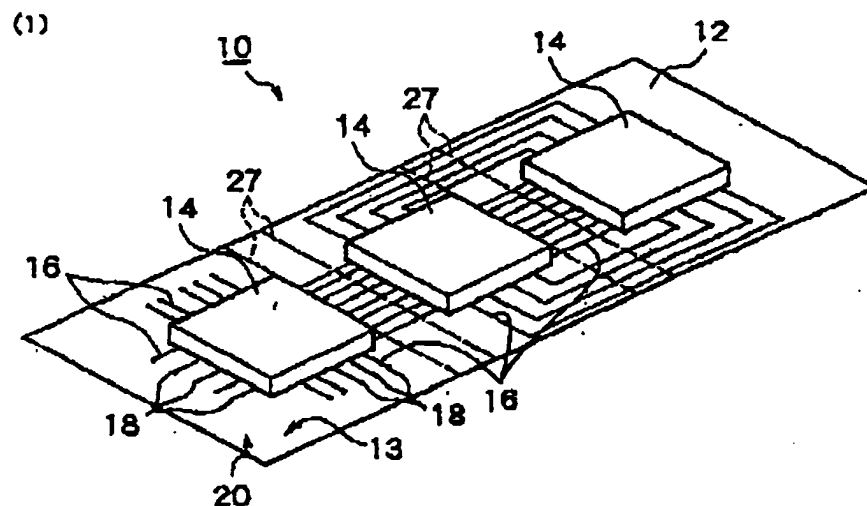
提出日 平成12年 1月12日

整理番号 = J 0 0 7 4 5 4 9

頁: 1/ 5

【 類名】 図面

【図1】



10: SEMICONDUCTOR DEVICE
12: CONNECTION SUBSTRATE
14: SEMICONDUCTOR CHIP
16: 1st METALLIC WIRING

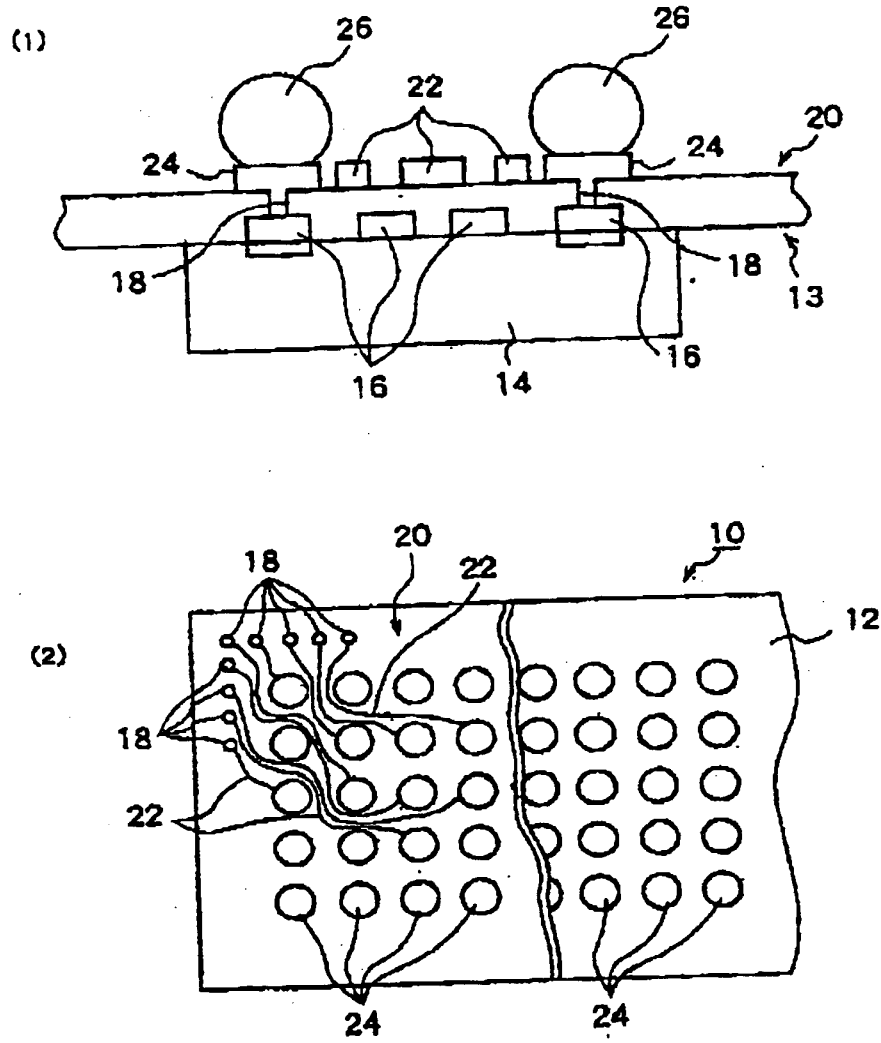
100110-48312500

提出日 平成12年 1月12日

整理番号=J0074549

頁: 2/5

【図2】

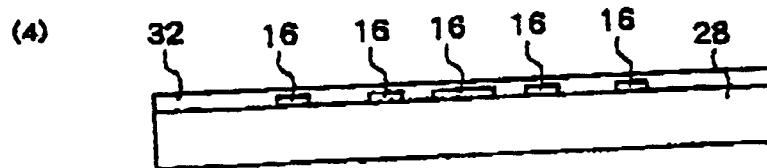
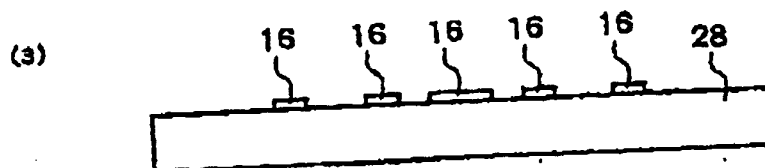
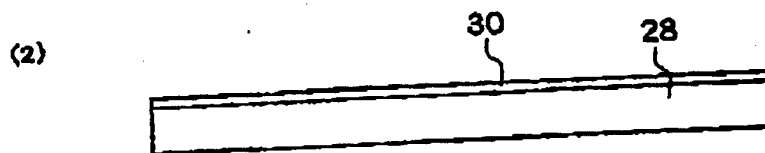
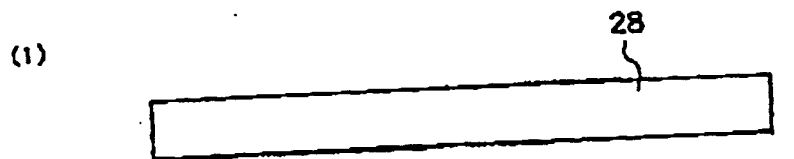


0061504-01001

提出日 平成12年 1月12日
頁: 3/ 5

整理番号=J0074549

【図3】



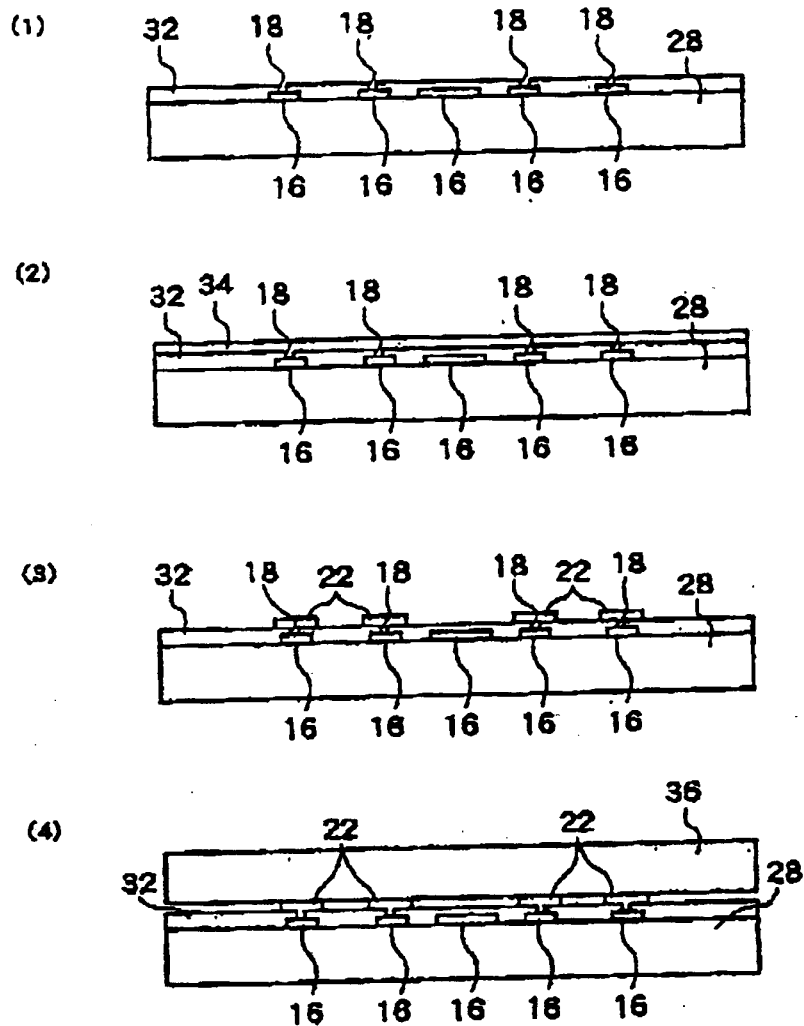
10010-48312900

提出日 平成12年 1月12日

整理番号=J0074549

頁: 4/ 5

【図4】



整理番号=J0074549

【図5】

